

10/525614
PCT/JP03/07169

05.06.03

日本特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月30日

RECEIVED

27 JUN 2003

WIPO PCT

出願番号

Application Number:

特願2002-255610

[ST.10/C]:

[JP2002-255610]

出願人

Applicant(s):

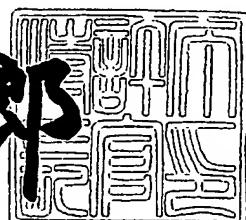
シャープ株式会社

PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

2003年 5月 6日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3032281

【書類名】 特許願
 【整理番号】 02J02609
 【提出日】 平成14年 8月30日
 【あて先】 特許庁長官 殿
 【国際特許分類】 H01L 21/3205
 B41J 2/01
 【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
 【氏名】 本多 充
 【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
 【氏名】 中林 敬哉
 【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内
 【氏名】 藤井 曜義
 【特許出願人】
 【識別番号】 000005049
 【氏名又は名称】 シャープ株式会社
 【代理人】
 【識別番号】 100080034
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 原 謙三
 【電話番号】 06-6351-4384
 【選任した代理人】
 【識別番号】 100113701
 【弁理士】

【氏名又は名称】 木島 隆一

【選任した代理人】

【識別番号】 100115026

【弁理士】

【氏名又は名称】 圓谷 徹

【選任した代理人】

【識別番号】 100116241

【弁理士】

【氏名又は名称】 金子 一郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003229

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0208489

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 パターン形成基材およびパターン形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

液滴を対象面上に吐出することで所定のパターンが形成されるパターン形成基材において、

上記対象面上に、上記液滴が対象面上に接触したときの接触角が第1接触角の第1領域と、この第1領域と隣接し、上記第1接触角よりも小さな第2接触角の第2領域とが、該第1領域と第2領域とに跨がるように液滴を付着させるときに、以下の(1)式を満たすように形成されていることを特徴とするパターン形成基材。

$$D \leq L \times \{1 + 2 (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)\} \quad \dots \dots \dots \quad (1)$$

ここで、D：液滴径

L：パターン幅

θ_1 ：第1接触角

θ_2 ：第2接触角

である。

【請求項2】

請求項1記載のパターン形成基材上の第1領域と第2領域とに跨がるように液滴を付着させることを特徴とするパターン形成方法。

【請求項3】

上記第1領域が液滴に対して撥液性を示す撥液領域となるように第1接触角を設定し、上記第2領域が液滴に対して親液性を示す親液領域となるように第2接触角を設定することを特徴とする請求項2記載のパターン形成方法。

【請求項4】

液滴を対象面上に吐出することで所定のパターンを形成するパターン形成方法において、

上記液滴を吐出する前に、該液滴に対して撥液性を示す第1領域と、該第1領域に隣接し、該液滴に対して親液性を示し、形成されるべきパターンとなる第2

領域とを上記対象面上に形成したときに、上記第1領域と第2領域との境界から液滴の付着中心との距離Xが、以下の(2)式を満たすように、液滴を対象面上に付着させることを特徴とするパターン形成方法。

【数1】

$$X \leq \sqrt{\frac{4}{2 - 3\cos\theta_1 + \cos^3\theta_1}} \cdot \frac{D}{2} \quad \dots \dots (2)$$

ここで、 X:親撥水パターン界面と液滴着弾中心との距離

D:液滴径

θ_1 :撥水部分のインクに対する接触角

【請求項5】

液滴を対象面上に吐出することで所定のパターンを形成するパターン形成方法において、

上記液滴を吐出する前に、該液滴に対して撥液性を示す第1領域と、該第1領域に隣接し、該液滴に対して親液性を示し、形成すべきパターンとなる第2領域とを上記対象面上に形成したときに、液滴を付着させるときの液滴の吐出ピッチPが、以下の(3)式を満たすように、液滴を対象面上に付着させることを特徴とするパターン形成方法。

【数2】

$$\frac{0.04D^3}{L} \leq P \leq \frac{0.4D^3}{L} \quad \dots \dots (3)$$

ここで、 P:吐出ピッチ(μm)

D:液滴径(μm)

L:親水ライン幅(μm)

【請求項6】

対象面上に、離散的に付着させた液滴同士をつなげて連続したパターンを形成することを特徴とする請求項2ないし5の何れか1項に記載のパターン形成方法

【請求項7】

液滴の吐出にインクジェットヘッドを用いることを特徴とする請求項2ないし

5の何れか1項に記載のパターン形成方法。

【請求項8】

上記第1領域および第2領域を、ほぼフラットに形成することを特徴とする請求項2ないし5の何れか1項に記載のパターン形成方法。

【請求項9】

液滴が導電性粒子を含むことを特徴とする請求項2ないし5の何れか1項に記載のパターン形成方法。

【請求項10】

上記第2領域が線状パターンであることを特徴とする請求項2ないし5の何れか1項に記載のパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、液滴を対象面上に吐出することで所定のパターンが形成されるパターン形成基材およびパターン形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、回路基板の配線パターンをインクジェット技術によって形成することが行なわれている。インクジェット技術を用いれば、配線パターンを基板上に直接形成できるので、従来のリソグラフィを用いた印刷技術のように、真空成膜→フォトリソ→エッチング→レジスト剥離工程といったコストのかかる工程を省略でき、その結果、安価に回路基板を作成することができるという効果を奏する。

【0003】

ところで、インクジェットヘッドを用いて配線パターンを形成する場合、配線材料を含む流動状のインク（液滴）を吐出し、基板上の所定の位置に着弾させて配線パターンを形成している。このように、液滴を吐出して基板に着弾させた場合、基板表面の特性から着弾した液滴が拡がり過ぎたり、分離したりする虞がある。このため、所望する配線パターンを得ることができないという問題が生じる。

【0004】

そこで、着弾した液滴が拡がり過ぎたり、分離したりすることを極力抑えて、所望する配線パターンを形成することのできる方法が、例えば、特開平11-204529号公報に開示されている。

【0005】

上記公報に開示された技術では、予め、配線パターンとなり得る領域を液滴と親和性を有するように、また、他の領域を液滴と非親和性を有するように基板表面を改質し、基板上の親和性を有する領域（パターン形成領域）に液滴を吐出し、配線パターンを形成している。この場合、パターン形成領域以外が液滴と非親和性の領域となっているので、基板上のパターン形成領域上に着弾された液滴は、該パターン形成領域を越えて広がることはない。

【0006】

また、上記公報に開示された技術では、着弾された液滴が分離したりしないように、液滴同士の一部が重なるように、液滴をパターン形成領域に着弾させていく。これにより、基板に着弾した液滴が分離したりするのを防止している。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、上記公報に開示されたパターン形成方法では、基板に着弾した液滴が分離したりするのを防止するために、着弾された液滴同士の一部が重なるように、液滴を吐出して配線パターンを形成しているので、吐出する液滴数が多い。このような場合、吐出する液滴数の増加に伴う、配線パターンを形成するまでの一連の処理時間（タクトタイム）の増加やインクジェットヘッドの寿命低下を招くという問題が生じる。

【0008】

本発明は、上記の各問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、吐出する液滴数を減らすことにより、タクトタイムの増加やインクジェットヘッドの寿命低下を防止し、良好な配線特性を得ることのできるパターン形成基材およびパターン形成方法を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するために、本発明のパターン形成基材は、液滴を対象面上に吐出することで所定のパターンが形成されるパターン形成基材において、上記対象面上に、上記液滴が対象面上に接触したときの接触角が第1接触角の第1領域と、この第1領域と隣接し、上記第1接触角よりも小さな第2接触角の第2領域とが、該第1領域と第2領域とに跨るように液滴を付着させると、以下の(1)式を満たすように形成されていることを特徴としている。

【0010】

$$D \leq L \times \{ 1 + 2 (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \} \quad \dots \dots \quad (1)$$

ここで、D：液滴径

L：パターン幅

θ_1 ：第1接触角

θ_2 ：第2接触角

である。

【0011】

上記の構成によれば、上記第2接触角が第1接触角よりも小さいことで、第2領域の方が第1領域に比べて、液滴との親液性が高いことになる。これにより、第1領域と第2領域とに跨るように液滴を付着した場合、第1領域に付着している液滴が該第1領域よりも親液性の高い第2領域（パターン）に集まることになる。

【0012】

しかも、液滴径、配線パターン幅、第1接触角、第2接触角を上記(1)式を満たすように設定すれば、配線パターン幅よりも大きな径の液滴を付着させても、液滴は第2領域に集まるようになる。

【0013】

このように、パターン幅よりも大きな径の液滴を使用すれば、パターン幅と同じ径、あるいは小さな径の液滴を使用した場合に比べて、液滴の吐出数を減らすことができる。

【0014】

このように、吐出する液滴数を減らすことにより、タクトタイムの増加や液滴を吐出するための機構、例えばインクジェットヘッドの寿命低下を防止することができる。

【0015】

液滴が配線材料を含み、この液滴で配線パターンを形成する場合、吐出する液滴数が減ることにより、液滴同士が重なりあって基板に付着するがなくなるので、配線の厚みのバラツキの低減、すなわち、配線抵抗のバラツキの低減を図ることができ、この結果、良好な配線特性を得ることができる。

【0016】

また、上記第1領域が液滴に対して撥液性を示す撥液領域となるように第1接触角を設定し、上記第2領域が液滴に対して親液性を示す親液領域となるように第2接触角を設定するようにしてもよい。

【0017】

この場合、第1領域が液滴に対して撥液性を示す撥液領域となり、第2領域が液滴に対して親液性を示す親液領域となるので、液滴を第1領域と第2領域とに跨るように付着させた場合、付着した液滴は撥液領域である第1領域では弾かれ、親液領域である第2領域では該第2領域の形状に沿って拡がる。つまり、第1領域で弾かれた液滴は、第2領域に流れ込み、第2領域に付着した液滴とともに該第2領域（パターン）に沿って拡がり配線を形成することになる。

【0018】

したがって、パターンとならない領域、すなわち第1領域を液滴に対して撥液性を有する領域にすることで、第1領域に付着した液滴を弾き、確実に第2領域に流し込むことが可能となる。

【0019】

このように、第1領域を撥液領域、第2領域を親液領域とすれば、第1接触角と第2接触角との差が大きくなり、上記（1）式の右辺が大きくなる。ここで、（1）式の右辺が大きくなることは、配線パターン幅に対する液滴径の大きさをさらに大きくすることができることを示す。

【0020】

したがって、液滴径をパターン幅に対してさらに大きくすることで、吐出する液滴数をさらに少なくでき、タクトタイムを減少させ、液滴を吐出するための機構、例えばインクジェットヘッドの寿命を延ばすことができる。

【0021】

また、本発明のパターン形成方法は、液滴を対象面上に吐出することで所定のパターンを形成するパターン形成方法において、上記液滴を吐出する前に、該液滴に対して撥水性を示す第1領域と、該第1領域に隣接し、該液滴に対して親水性を示し、形成されるべきパターンとなる第2領域とを上記対象面上に形成したときに、上記第1領域と第2領域との境界から液滴の付着中心との距離Xが、以下の（2）式を満たすように、液滴を対象面上に付着させることを特徴としている。

【0022】

【数3】

$$X \leq \sqrt[3]{\frac{4}{2 - 3\cos\theta_1 + \cos^3\theta_1}} \cdot \frac{D}{2} \quad \dots \dots (2)$$

ここで、 X:親撥水パターン界面と液滴着弾中心との距離

D:液滴径

θ_1 :撥水部分のインクに対する接触角

【0023】

上記の構成によれば、第1領域と第2領域との境界から液滴の付着中心との距離Xが、上記の（2）式を満たすように、液滴を対象面上に付着させることで、撥水性を示す第1領域に付着した液滴は親水性を示す第2領域に移動することができる。つまり、液滴の付着中心が第2領域になくても、液滴を第2領域に移動させることができる。

【0024】

これにより、吐出精度の低い液滴吐出機構、例えばインクジェットヘッドを使用し、液滴を基板に吐出しても、形成すべきパターンとなる第2領域に確実に液滴を集めることができるので、精度よくパターンを形成することができる。

【0025】

したがって、パターンを形成するための装置コストを低減することが可能となる。

【0026】

ここで、液滴が移動することが可能な範囲は、パターン形状の許す限り大きい液滴とし、撥液領域である第1領域での液滴の接触角（第1接触角）は小さくしたほうが広くなる。

【0027】

さらに、本発明のパターン形成方法は、液滴を対象面上に吐出することで所定のパターンを形成するパターン形成方法において、上記液滴を吐出する前に、該液滴に対して撥液性を示す第1領域と、該第1領域に隣接し、該液滴に対して親液性を示し、形成すべきパターンとなる第2領域とを上記対象面上に形成したときに、液滴を付着させるときの液滴の吐出ピッチPが、以下の(3)式を満たすように、液滴を対象面上に付着させることを特徴としている。

【0028】

【数4】

$$\frac{0.04D^3}{L} \leq P \leq \frac{0.4D^3}{L} \quad \dots \dots (3)$$

ここで、P:吐出ピッチ(μm)

D:液滴径(μm)

L:親水ライン幅(μm)

【0029】

上記の構成によれば、吐出する液滴径とパターン幅とに対して、液滴の吐出ピッチPを上記(3)式を満たすように設定することで、線幅、線厚のバラツキの少ないパターンを形成することができる。

【0030】

ここで、液滴が配線材料を含み、所定のパターンとして配線パターンを形成する場合には、配線幅、配線厚のバラツキが少なく、低抵抗かつ配線段差の少ない配線パターンを高スループットで形成することが可能となる。

【0031】

このように、液滴の吐出ピッチを上記（3）式を満たすように設定することで、パターンの形成に必要な液滴の吐出数を最小限にすることが可能となり、タクトタイムの減少や液滴を吐出する機構（インクジェットヘッド）の延命化を図ることができる。

【0032】

また、対象面上に、離散的に付着させた液滴同士をつなげて連続したパターンを形成してもよい。

【0033】

この場合、液滴の吐出数を必要最小限にすることが可能となるので、タクトタイムの減少、液滴を吐出する機構の長寿命化を図ることが可能となる。

【0034】

上記液滴の吐出にインクジェットヘッドを用いてもよい。

【0035】

この場合、液滴を吐出するための機構として、プリンタ等に用いられる汎用のインクジェットヘッドを流用することができるので、パターン形成のための装置を安価に製造することができる。

【0036】

上記第1領域および第2領域を、ほぼフラットに形成してもよい。

【0037】

この場合、ほぼフラットとは、第1領域と第2領域との段差が、形成されるパターン厚みと比べて非常に小さい状態をいう。このようにすることで、第1領域と第2領域との液滴に対する親和性の差を明確にするためにバンクを形成する必要がないので、パターン形成の工程数を短縮することができる。

【0038】

液滴が導電性粒子を含むようにしてもよい。

【0039】

この場合、液滴を吐出して形成されるパターンが配線パターンとなるので、線幅、線厚のバラツキのない配線パターンを形成することができる。また、吐出す液滴数が減ることにより、液滴同士が重なりあって基板に付着することができなく

なるので、配線の厚みのバラツキの低減、すなわち、配線抵抗のバラツキの低減を図ることができ、この結果、良好な配線特性を得ることができる。

【0040】

上記第2領域が線状パターンであってもよい。

【0041】

この場合、線状とすることで配線形成が可能となる。また、とりわけ幅の狭い線状パターンとすることで、配線密度を高くすることが可能となる。さらに、液晶パネル用配線に用いる場合は、ゲート・ソース・ドレイン配線は線状にすることが不可欠であり、特に、ゲート・ソース・ドレイン配線は金属材料で形成されるため、パネル輝度向上のためには、配線幅は狭いほうが望ましい。

【0042】

【発明の実施の形態】

【実施の形態1】

本発明の一実施の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、液晶パネルの製造工程のうち、TFT (Thin Film Transistor) のゲート配線のパターン形成方法について説明する。

【0043】

まず、本発明のパターン形成方法を実現するためのパターン形成装置について、以下に説明する。

【0044】

本実施の形態にかかるパターン形成装置は、図5に示すように、基板11を載置するステージ12を備え、このステージ12上に、該基板11上に対して配線材料を含む流動状のインク（液滴）を吐出する液滴吐出手段としてのインクジェットヘッド13と、インクジェットヘッド13をy方向に移動させるy方向駆動部14およびx方向に移動させるx方向駆動部15とが設けられている。

【0045】

また、上記パターン形成装置には、インクジェットヘッド13に液滴を供給する液滴供給システム16と液配管18、インクジェットヘッド13の吐出制御、y方向駆動部14、x方向駆動部15の駆動制御等の各種制御を行なう装置コン

トロールユニット17とが設けられている。

【0046】

上記インクジェットヘッド13と液滴供給システム16との間には、液配管18が設けられており、液滴供給システム16によってインクジェットヘッド13への液滴の供給制御が行なわれる。

【0047】

また、上記インクジェットヘッド13、y方向駆動部14およびx方向駆動部15と装置コントロールユニット17との間には、信号ケーブル（図示しない）が設けられており、装置コントロールユニット17によって、インクジェットヘッド13の液滴の吐出制御、y方向駆動部14、x方向駆動部15の駆動制御が行なわれる。

【0048】

すなわち、上記装置コントロールユニット17から、基板11への配線パターン情報（塗布位置情報）をy方向駆動部14、x方向駆動部15と連動してインクジェットヘッド13のドライバー（図示せず）に吐出情報が入力され、目的位置に目的量の液滴を供給するようになっている。これにより、基板11の全領域に対して、液滴を滴下することが可能となる。

【0049】

上記インクジェットヘッド13としては、電圧を印加すると変形する圧電素子を使用し、瞬間にインク室の液圧を高めることでノズルから液体（液滴）を押し出すピエゾ方式のインクジェットヘッドや、ヘッドに取り付けたヒータによって、液体内に気泡を発生させ、液体を押し出すサーマル方式のインクジェットヘッドが使用される。何れの方式のインクジェットヘッドであっても、圧電素子やヒータに印加する電圧に応じて、吐出する液滴径を調整することができる。

【0050】

本実施の形態では、上述したパターン形成装置において、インクジェットヘッド13として、 $55\mu m$ 径の複数ノズルを備えたピエゾ駆動型インクジェットヘッドを用いて、駆動電圧波形を変化させることにより、吐出液滴径を $50\mu m$ から $75\mu m$ まで変化させるようになっている。

【0051】

次に、上記パターン形成装置によって、基板11上への配線パターンの形成方法について、図1(a) (b)を参照しながら以下に説明する。図1(a)は、液滴の基板への着弾前後の状態を示す側面図を示し、図1(b)は、液滴の基板への着弾前後の状態を示す平面図を示す。

【0052】

本実施の形態にかかるパターン形成基材は、図1(a) (b)に示すように、基板11上に配線パターンとなる親水ライン(第1領域)6と、撥水領域(第2領域)7とを形成し、親水ライン6上に該親水ライン6の線幅Lよりも大きな径Dの液滴8を吐出し、該液滴8が有するエネルギー状態の変化によって、該液滴8を親水ライン6内に治めるようとするものである。つまり、液滴8の径Dが親水ライン6の幅Lよりも大きい場合、着弾直後に親水ライン6からはみ出した液滴8は撥水領域7により弾かれて、親水ライン6に集まるようになる。

【0053】

なお、上記親水ライン6と撥水領域7とは、後述するように、化学的な処理が施されて得られるものであるので、基板11上でほぼフラットな状態となっている。このため、従来のようにパンクを形成して、配線パターンを形成する場合に比べて、製造工程数を減らすことができる。

【0054】

上記のパターン形成基材を用いれば、配線パターンの線幅よりも大きな径の液滴を使用しても、全ての液滴が配線パターンに集まるようになるので、少ない液滴数で配線パターンを形成することができる。さらに、吐出する液滴数が少なければ、タクトタイムの減少、インクジェットヘッドの長寿命化を図ることが可能となる。

【0055】

まず、図1(a)のように直径Dの液滴8が、両側を撥水領域7に挟まれたライン幅Lの等幅の親水ライン6上に滴下された場合を考える。前記液滴8が図2(a)のように撥水領域7に滴下された場合の接触角を θ_1 、親水領域である親水ライン6に滴下された場合の接触角を θ_2 とすると、両側を撥水領域7に挟ま

れたライン幅Lの等幅の親水ライン6上に滴下された場合、接触角はカッシーの接触角 θ_c をとる。 $(\theta_1 > \theta_c > \theta_2)$ また、液滴8の表面エネルギーを γ とし、滴下された液滴8の半径がxだけ収縮し親水ライン6に沿って伸びる間に、液滴8の変形に伴い消費されるエネルギー ΔW は、

$$\Delta W = 2D\gamma (\cos \theta_2 - \cos \theta_1) x$$

と近似することができる。

【0056】

同じく変形に伴う表面積の増加量を ΔS とすると、変形によって増加する液滴8の表面エネルギー $\gamma \Delta S$ は

$$\gamma \Delta S = \gamma (D - L) D x / L$$

と近似することができる。

【0057】

したがって、上記二つの和で表されるすべてのエネルギー変化 ΔE は、

$$\Delta E = \gamma \{ D - L - 2L(\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \} Dx / L$$

と表すことができる。

【0058】

ここで、 $D - L - 2L(\cos \theta_2 - \cos \theta_1) > 0$ 、すなわち

$$L < D / \{ 1 + 2(\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \}$$

液滴8の変形に対して ΔE は単調増加となるため、変形は生じない。

【0059】

また、 $D - L - 2L(\cos \theta_2 - \cos \theta_1) < 0$ 、すなわち

$$L > D / \{ 1 + 2(\cos \theta_2 - \cos \theta_1) \}$$

液滴8の変形に対して ΔE は単調減少となるため、すべて親水ライン6に入るまで、液滴8は変形し続ける。

【0060】

例えば、第2接触角 θ_2 が 0° 、第1接触角 θ_1 が 90° のときは、 $D < 3L$ となり、親水ラインの線幅の3倍までの径の液滴を使用しても配線を適切に形成できることになる。つまり、この場合、液滴径の $1/3$ の線幅の配線を形成することができることになる。

【0061】

また、第2接触角 θ_2 が 0° 、第1接触角 θ_1 が 180° のときは、 $D < 5L$ となり、親水ラインの線幅の5倍までの径の液滴を使用しても配線を適切に形成できることになる。つまり、この場合、液滴径の $1/5$ の線幅の配線を形成することができるうことになる。

【0062】

したがって、上記(1)式に含まれる4つのパラメータ(θ_1 、 θ_2 、 D 、 L)を調整し、該(1)式を満たすようにすれば、液滴径 D と配線パターンの線幅 L との関係を適切なものにすることができる。例えば、液滴径 D が固定されていれば、必要な配線パターンの線幅 L を得るために、第1接触角 θ_1 、第2接触角 θ_2 を調整する。

【0063】

ここで、配線パターン形成についての具体例を以下に説明する。

【0064】

まず、配線パターンを形成する前に、基板11の表面改質処理について、図3(a)～図3(d)を参照しながら以下に説明する。図3(a)～図3(d)は、配線パターンの形成前の基板11の表面改質処理の各工程を示す図である。

【0065】

まず、図3(a)に示すように、ガラス基板1上に、スピンドル法等を用いて、シランカップリング剤などからなる濡れ性変化層2を塗布・乾燥させることで形成した。なお、本実施の形態では、濡れ性変化層2として、フッ素系非イオン界面活性剤であるZONYL FSN(商品名、デュポン社製)をイソプロピルアルコールに混合して用いた。

【0066】

次に、図3(b)に示すように、あらかじめクロムなどからなるマスクパターン4および酸化チタンなどからなる光触媒層5が形成されたフォトマスク3を通じてUV露光を行なった。なお、本実施の形態では、光触媒層5は、二酸化チタン微粒子分散体とエタノールの混合物をスピンドル法を用いて塗布した後、150℃で熱処理することで形成している。また、露光条件は、水銀ランプ(波長

365 nm) により 70 mW/cm² の照度で 2 分間露光を行なった。

【0067】

その結果、図3(c) および図3(d) に示すように、UV露光された部分だけが濡れ性が向上し、親水ライン6が形成された。なお、本実施の形態では、形成した親水ライン6の幅を 50 μm とした。

【0068】

ここで、親水ライン6以外の領域は、撥水領域7となり、基板11上に配線パターンとしての親撥水パターンが形成されることになる。

【0069】

そして、親撥水パターンを形成した基板11上にゲート配線材料を、上述したパターン形成装置を用いて滴下することで、ゲート配線を形成する。

【0070】

配線形成に用いた液体配線材料(液滴)は、A g 微粒子を水とエタノールとジエチレングリコールの混合溶剤に分散させたものを用い、粘度はあらかじめ約10 cP に調整している。ここで、図2(a) に示すように、上述した処理により得られた撥水領域7上における上記液滴の第1接触角θ₁は 80°、図2(b) に示すように、上述した処理により得られた親水ライン6上における上記液滴の第2接触角θ₂は 10° であった。

【0071】

上述したパターン形成装置を用いて、図1(a) に示すように、親撥水パターンを形成した基板11上に液滴8を滴下する。吐出液滴径Dが 75 μm の場合、図1(b) に示すように滴下した液滴8は親水ライン6に沿ってライン形状を形成する。なお、液滴8の着弾位置は親水ライン6の中央とした。

【0072】

上記(1)式に、第1接触角θ₁=80° と第2接触角θ₂=10° とを代入して液滴径Dと親水ライン幅Lとの関係を求めると、以下のようになる。

【0073】

$$D \leq 2.62L$$

これは、上記条件の場合に、液滴径Dは、親水ライン幅Lの約2.62倍まで

大きくしても、ライン形成が可能であることを示している。つまり、液滴径Dの $1/2 = 0.38$ の幅のラインが形成できることを示している。

【0074】

上記と同様の条件で、幅の異なる親水ライン6上に滴下した場合の結果を以下の表1に示す。

【0075】

【表1】

ライン幅(μm)	75	50	30	20
結果	○	○	○	×

○:ライン形成可能

×:ライン形成不可

【0076】

表1から、ライン幅20μmでは、ライン形成が不可能であることが分かった。これは、ライン幅20μmの場合、 $20/75 = 0.27$ となり、上述した0.38よりも小さいので、上記(1)式を満たさなくなるからだと考えられる。

【0077】

また、液滴8のサイズ、すなわち液滴径Dを変化させて、幅の異なる親水ライン6上に滴下した場合の結果を以下の表2に示す。ただし、液滴径D=35μmの場合はインクジェットヘッドを交換している。

【0078】

【表2】

ライン幅(μm)	30	20	15	10
液滴径 65 μm	○	×	×	×
液滴径 50 μm	○	○	×	×
液滴径 35 μm	○	○	○	×

○:ライン形成可能

×:ライン形成不可

【0079】

表2においても、上記(1)式を満たさない場合には、ライン形成が不可能であることが分かった。

【0080】

ここで、液滴径Dと吐出ピッチとの関係について、以下に説明する。

【0081】

パターン形成方法及びゲート配線の形成方法、用いたパターン形成装置、インクジェットヘッド13は上記の例と同じである。また、配線形成に用いた液体配線材料（液滴8）は、Ag微粒子を水に分散させたものを用い、粘度はあらかじめ約5cPに調整している。この場合、図2(a)に示すように、撥水領域7上における液滴8の第1接触角 θ_1 は100°、図2(b)に示すように、親水ライン6上における液滴8の第2接触角 θ_2 は10°であった。

【0082】

上述したパターン形成装置を用いて、図1(a)に示すように、親撥水パターンを形成した基板11上に液滴8を滴下する。液滴8の着弾位置は親水ライン6の中央とした。

【0083】

そして、液滴サイズを変化させて、Ag濃度10vo1%のインク材料（液滴8）を親水ライン幅25μmに対して、膜厚0.3μmと設定し、滴下した場合の結果を以下の表3に示す。ただし、液滴径が25μmから45μmの場合はヘッドを交換している。

【0084】

【表3】

親撥水境界からの距離(μm)	40	50	100	110
液滴径75μm	○	○	○	×
液滴径35μm	○	×	×	×

○:ライン形成可能

×:ライン形成不可

【0085】

以上の結果からも、上記(1)式を満たすことで、ライン形成が可能であり、吐出液滴径Dを大きくするほど吐出ピッチを大きくすることが可能となり、タクトタイムを短縮およびヘッドの寿命を長くすることが可能となることが分かる。

【0086】

上記表3に示す結果をプロットしたものを、図4に示す。図4に示すグラフから、液滴径Dが50μm以上とすることでピッチを飛躍的に大きくすることができるため、タクトタイムの短縮およびヘッドの長寿命化のためには、

$$2L \leq D \leq L \{1 + 2(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)\}$$

に設定することが望ましいことが分かる。

【0087】

さらに、図4に示すグラフから、液滴径が $54 \mu m$ 以上では、液滴径がライン幅と同じ場合と比較してピッチを10倍以上に広げることが可能となり、結果としてタクトタイムを1/10、ヘッド寿命を10倍に延ばすことが可能となることが分かる。

【0088】

したがって、タクトタイムの短縮およびヘッドの長寿命化のためには、

$$2.15L \leq D \leq L \{1 + 2(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)\}$$

に設定することがさらに好ましいことが分かる。

【0089】

以上のことから、液滴径Dを、 $D \leq L \{1 + 2(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)\}$ 、好ましくは、 $2L \leq D \leq L \{1 + 2(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)\}$ 、さらに好ましくは、 $2.15L \leq D \leq L \{1 + 2(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)\}$ の関係を満たすように設定することで、大きな液滴で広いピッチで吐出することができるため、タクトタイムの短縮とヘッドの長寿命化を確保することが出来る。

【0090】

すなわち、対象面である基板11の親水ライン6上に、離散的に付着させた液滴8同士をつなげて連続したパターンを形成することになる。これにより、液滴8の吐出数を必要最小限にすることが可能となるので、タクトタイムの減少、液滴を吐出する機構（インクジェットヘッド）の長寿命化を図ることが可能となる。

【0091】

また、タクトタイムの短縮とヘッドの長寿命化を確保するために、液滴の吐出ピッチを広く設定した場合、形成するライン幅が部分的に狭くなっている部分などが存在する場合、その部分だけ液滴がラインに入らない問題が生じるが、形成したいライン幅に応じて、ヘッドの駆動波形等を制御することで吐出液滴径を変化させることによって、ライン幅に関わらず、すべての幅のラインを十分なタク

トタイムと十分なヘッド寿命で形成することが可能となる。

【0092】

このように、ライン幅に応じて、吐出する液滴径を変化させる例について、以下の実施の形態2で説明する。

【0093】

〔実施の形態2〕

本発明の他の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、パターン形成装置については、前記実施の形態1と同じものを使用するので、その説明は省略する。

【0094】

本実施の形態においても、前記実施の形態1と同様に、TFT液晶ディスプレイパネルのゲート配線パターンの形成方法について説明する。

【0095】

図6(a)は、本実施の形態で用いるゲート配線パターンを示す。このゲート配線パターンでは、親水ライン21と撥水領域22とで形成される親撥水パターンであり、親水ライン21の線幅が一様ではなく、一部の部分で線幅が狭くなっている部分がある。つまり、親水ライン21は、親水ライン21a～21dのように線幅がそれぞれ異なっている。ここで、他のラインよりも狭い親水ライン21b、21cの線幅は $20\mu m$ 、それ以外の部分(親水ライン21a、21d)の線幅は $30\mu m$ である。この親撥水パターンの生成方法は、前記実施の形態1と同様である。

【0096】

次に、親撥水パターンを形成した基板上にゲート配線材料をインクジェット法を用いて滴下することで、ゲート配線を形成する。ここで、用いたパターン形成装置、インクジェットヘッド13は、前記実施の形態1と同様であり、吐出液滴径を $50\mu m$ から $75\mu m$ まで変化させることが可能とする。

【0097】

また、用いた液体配線材料(液滴)も前記実施の形態1と同じであり、撥水領域22上における液滴の第1接触角 θ_1 は 80° 、親水ライン21上における液

滴の第2接触角 θ_2 は10°である。

【0098】

そして、図6(b)に示すように、親水ライン21上にある液滴23をインクジェットヘッドを用いて滴下するが、線幅30μmのパターン上には液滴径75μmで、線幅20μmのパターン上には液滴径50μmで滴下している。このように、線幅によって液滴径を変化させることで、すべての親水ライン21に液滴23を配置することが出来る(図6(c))。

【0099】

なお、線幅20μmのパターン上にも液滴径75μmで滴下した場合には、線幅20μmのパターンには、配線材料は入らなかった。また、すべてのパターン上に液滴径50μmで滴下した場合は、配線形成は可能であるが、線幅30μmのパターンに液滴径75μmで滴下した場合と比較してタクトタイムが増加した。そのため、望ましくは、それぞれの線幅に対して、

$$2L \leq D \leq L \{1 + 2(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)\}$$

を満たすよう液滴径を変化させることがよく、さらに好ましくは、それぞれの線幅に対して、

$$2.15L \leq D \leq L \{1 + 2(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)\}$$

を満たすよう液滴径を変化させることで、線幅の異なるパターンにおいても液滴を入れることが可能となり、かつ、十分なタクトタイムと十分なヘッド寿命を得ることが可能となる。

【0100】

上記の各実施の形態では、液滴を親水ラインの中央に滴下することを前提とした例について説明したが、液滴を親水ラインの中央に滴下するには精度の高いインクジェットヘッドを使用する必要がある。しかしながら、滴下精度の高いインクジェットヘッドは高価であるので、パターン形成装置全体の価格上昇を招く虞がある。

【0101】

そこで、以下の実施の形態3では、液滴が親水ラインの中央に滴下されなくても、親水ライン上に集まりラインを形成することのできるパターン形成方法につ

いて説明する。

【0102】

〔実施の形態3〕

本発明のさらに他の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、前記実施の形態1と同様に、図3(a)～図3(d)に示す表面改質処理方法によって、基板11の表面が改質され、親水ライン6と撥水領域7とで親撥水パターンを形成し、この親撥水パターンを用いて配線ラインを形成する例について説明する。

【0103】

本実施の形態にかかるパターン形成方法は、図7(a)に示すように、液滴8の基板11への着弾直後において、液滴8が親水ライン6の中心からはずれた状態になっているときに、図7(b)に示すように、液滴8を親水ライン6上に移動させる方法である。

【0104】

我々は、液滴8が基板11に着弾した時、液滴8の基板11への接地面の一部でも親水ライン6上に存在することで、液滴8全体が撥水領域7から親水ライン6に移動することができることを見出した。すなわち、親水ライン6と撥水領域7の境界と液滴8の着弾位置の距離を、液滴8が着弾した時の円形接地面の半径よりも小さく設定することで、液滴8全体が撥水領域7から親水ライン6に移動することができる。ここで、着弾前の液滴の半径を R_1 、液滴の撥水領域での接触角を θ_1 、液滴が着弾した時の円形接地面の半径 R_2 とすると、

$$R_2 = R_1 \times 3\sqrt{(4 / (2 - 3 \cos \theta_1 - \cos^3 \theta_1))}$$

であるから、上記 R_2 を液滴径Dに換算すると、以下の(2)式が得られる。

【0105】

【数5】

$$X \leq \sqrt[3]{\frac{4}{2 - 3\cos\theta_1 + \cos^3\theta_1}} \cdot \frac{D}{2} \quad \dots \dots (2)$$

ここで、 X: 親撥水パターン界面と液滴着弾中心との距離

D: 液滴径

θ_1 : 撥水部分のインクに対する接触角

【0106】

すなわち、本実施の形態にかかるパターン形成方法は、インクジェット法で親撥水下地パターンを用いてパターン（ライン状に限定しない）を形成する場合において、図7（a）に示すように、液滴8の着弾位置を親撥水境界6aから以下の（2）式で規定した範囲内に設定することで、図7（b）に示すように、撥水領域7から液滴8を移動させることができるために、液滴8の着弾位置が親水ライン6上になくとも、所定の位置に液滴を移動させることができ、精度の低いインクジェットヘッドを用いた場合でも、精度よくパターンを形成することが可能となり、パターン形成装置の製造にかかるコストの低減を図ることができる。

【0107】

なお、親撥水パターン形状の許す限り大きい液滴8とし、撥水領域7の液滴8の接触角は小さくしたほうが、液滴8が移動することが可能な範囲は広くなる。

【0108】

【数6】

$$X \leq \sqrt[3]{\frac{4}{2 - 3\cos\theta_1 + \cos^3\theta_1}} \cdot \frac{D}{2} \quad \dots \dots (2)$$

ここで、 X: 親撥水パターン界面と液滴着弾中心との距離

D: 液滴径

θ_1 : 撥水部分のインクに対する接触角

【0109】

ここで、親水ライン幅50 μmの場合に、液滴の着弾位置を変化させた場合の結果を、以下の表4に示す。なお、配線形成に用いた液体配線材料（液滴）は、A g微粒子を水とエタノールとジエチレン glycole の混合溶剤に分散させたも

のを用い、粘度はあらかじめ約10cPに調整している。ここで、図2(a)に示すように、上述した処理により得られた撥水領域7上における上記液滴8の第1接触角 θ_1 は80°、図2(b)に示すように、上述した処理により得られた親水ライン6上における上記液滴8の第2接触角 θ_2 は10°であった。

【0110】

【表4】

液滴径 D(μm)	25	30	40	45	50	55	65	70	75	80	85
ピッチ(mm)	0.11	0.19	0.45	0.64	0.87	1.16	1.92	2.39	2.94	3.57	×

図中記号×:ライン形成不可NG

【0111】

表4において、液滴径75μmの場合には、親撥水境界6aからの距離が100μmまでライン形成が可能であったが、液滴径35μmの場合には、親撥水境界6aからの距離が40μmまでライン形成が可能であることが分かった。

【0112】

以上のように、インクジェットヘッドによる滴下実験により、滴下後、液滴の接地面の一部でも親水ライン上にあれば、液滴全体が親水ライン上に移動することが確認されている。そこで、上記(2)式で規定したように、予め着弾前の液滴半径と着弾位置を設定することにより、低い精度のインクジェットヘッドを用いた場合にも精度よくパターン形成することができる。

【0113】

【実施の形態4】

本発明のさらに他の実施の形態について説明すれば、以下の通りである。なお、本実施の形態では、前記実施の形態1と同様に、図3(a)～図3(d)に示す表面改質処理方法によって、基板11の表面が改質され、親水ライン6と撥水領域7とで親撥水パターンを形成し、この親撥水パターンを用いて配線ラインを形成する例について説明する。

【0114】

本実施の形態にかかるパターン形成方法について、図8(a)(b)を参照しながら以下に説明する。図8(a)は、液滴8の着弾直前の側面図であり、図1

2 (b) は、液滴8の着弾直前の平面図である。

【0115】

本パターン形成方法では、吐出液滴径と配線を形成する親水ライン幅に対して吐出ピッチを以下の(3)式を満たすように設定することで、配線幅、配線厚のバラつきが少なく、低抵抗かつ配線段差の少ない導体パターンを高スループットで形成可能にすることができる。

【0116】

【数7】

$$\frac{0.04D^3}{L} \leq P \leq \frac{0.4D^3}{L} \quad \dots \dots (3)$$

ここで、P:吐出ピッチ(μm)

D:液滴径(μm)

L:親水ライン幅(μm)

【0117】

上記(3)式は、以下のようにして求めることができる。

【0118】

ここで、本実施の形態にかかるパターン形成方法では、予め親水ライン幅Lのパターンを基板に形成している場合は、液滴径Dと吐出ピッチPを制御することで配線の膜厚を制御することを利用した方法である。

【0119】

したがって、上記(3)式を得るために、以下の項目を計算で求める必要がある。

【0120】

①液滴径Dと吐出ピッチPから求められる液滴の全体積V

②液滴の全体積Vと親水ライン幅Lから算出される膜厚

③パターン形成に適した膜厚の条件により算出される吐出ピッチP

上記吐出ピッチP(μm)とすると、1 μm あたりのドット数は $1/P$ (dot/ μm)となる。

【0121】

また、液滴径をDとすると、体積Vは、 $V = \pi D^3 / 6$ となるため、1 μmあたりの全体積は、

$$1 / P \times \pi D^3 / 6 = \pi D^3 / 6 P (\mu m^3)$$

である。

【0122】

ライン幅をL (μm) とすると、液滴の高さは $\pi D^3 / 6 L P$ となり、Ag濃度をb (v o 1%) とすると、Agの高さt (μm) は、

$$t = \pi b D^3 / 600 L P$$

と表せる。

【0123】

変形すると吐出ピッチPは、 $P = (\pi b / 600 t) \times (D^3 / L)$ となる。

【0124】

ここで、吐出液滴径と配線を形成する親水ライン幅に対して、我々は $\pi b / 600 t$ を0.04以上0.4以下に設定することで配線幅、配線厚のバラツキが少なく、低抵抗かつ配線段差の少ない配線パターンを高スループットで形成することが可能となることを見出した。

【0125】

ここで、上記パターン形成方法において、親水ライン幅50 μmに75 μm径の液滴を着弾ピッチを変化させて滴下した場合の配線形成結果を以下の表5に示す。表中数値は、インクジェット工程の後、液体配線材料を250°C/10分で熱処理することで、溶媒を乾燥させ、材料を焼成した後の配線形成膜厚を示したものである。なお、液体配線材料は、液中にAg微粒子を10体積%の割合で含有しているものを用いた。

【0126】

【表5】

着弾ピッチ(μm)	350	400	1500	3000	3500
結果(膜厚 μm)	△(1.47)	○(1.10)	○(0.30)	○(0.15)	×(0.13)

○:配線特性良好

△:配線段差が大きすぎNG

×:配線抵抗が大きすぎNG

【0127】

表5から、着弾ピッチが $350\text{ }\mu\text{m}$ と小さくても、また、着弾ピッチが $350\text{ }\mu\text{m}$ と大きくても適切な配線パターンを得ることができないことが分かった。

【0128】

同様に、上記パターン形成方法において、親水ライン幅 $20\text{ }\mu\text{m}$ に $50\text{ }\mu\text{m}$ 径の液滴を着弾ピッチを変化させて滴下した場合の配線形成結果を以下の表6に示す。表中数値は、インクジェット工程の後、液体配線材料を $250^{\circ}\text{C}/10\text{ 分}$ で熱処理することで、溶媒を乾燥させ、材料を焼成した後の配線形成膜厚を示したものである。なお、液体配線材料は、液中に Ag 微粒子を 10 体積\% の割合で含有しているものを用いた。

【0129】

【表6】

着弾ピッチ(μm)	200	250	1000	2300	2600
結果(膜厚 μm)	$\Delta(1.64)$	$\bigcirc(1.31)$	$\bigcirc(0.33)$	$\bigcirc(0.14)$	$\times(0.13)$

○:配線特性良好 Δ :配線段差が大きすぎNG \times :配線抵抗が大きすぎNG

【0130】

表6から、着弾ピッチが $200\text{ }\mu\text{m}$ と小さくても、また、着弾ピッチが $260\text{ }\mu\text{m}$ と大きくても適切な配線パターンを得ことができないことが分かった。

【0131】

以上のことから、液滴材料が同じであれば、着弾ピッチは、親水ライン幅、液滴径に応じて適切な範囲が決まることが分かる。

【0132】

なお、上記の各実施の形態においては、配線形成に用いた液体配線材料（液滴）は、 Ag 微粒子を水とエタノールとジエチレングリコールの混合溶剤に分散させたものを使用していたので、親液性を親水性、撥液性を撥水性と表現し記載しているが、例えば、液滴の配線材料を混合する溶剤が水系ではなく油系であってもよい。この場合には、親液性を親油性、撥液性を撥油性と表現すればよい。

【0133】

また、上記の各実施の形態では、液滴をパターン形成基材である基板11に吐出するための機構として、インクジェットヘッドを利用したインクジェット方式

を用いた例について説明したが、これに限定されるものではなく、液滴径が制御でき吐出できる機構であればよい。

【0134】

また、インクジェットヘッドも、ピエゾ型に限定されるものではなく、バブルジェット（登録商標）のようなサーマル型であってもよい。

【0135】

さらに、基板11上に形成される第2領域（親水ライン6）は線状であればよい。この線状とは、前記の各実施の形態で示したような短冊形状でなくてもよく、蛇行していてもよいし、テーパ状であってもよい。また、これらの形状を組み合わせたものであってもよい。さらに、上記線状は、必ずしも輪郭線が直線的でなくともよく、曲線、ジグザグ形状を含んでもよい。

【0136】

このように、親水ライン6を線状とすることで配線形成が可能となる。また、とりわけ幅の狭い線状パターンとすることで、配線密度を高くすることが可能となる。さらに、液晶パネル用配線に用いる場合は、ゲート・ソース・ドレイン配線は線状にすることが不可欠であり、特に、ゲート・ソース・ドレイン配線は金属材料で形成されるため、パネル輝度向上のためには、配線幅は狭いほうが望ましい。

【0137】

【発明の効果】

以上のように、本発明のパターン形成基材は、液滴を対象面上に吐出することで所定のパターンが形成されるパターン形成基材において、上記対象面上に、上記液滴が対象面上に接触したときの接触角が第1接触角の第1領域と、この第1領域と隣接し、上記第1接触角よりも小さな第2接触角の第2領域とが、該第1領域と第2領域とに跨るように液滴を付着させるとときに、以下の（1）式を満たすように形成されている構成である。

【0138】

$$D \leq L \times \{1 + 2 (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)\} \quad \dots \dots \quad (1)$$

ここで、D：液滴径

L : パターン幅

θ_1 : 第1接触角

θ_2 : 第2接触角

である。

【0139】

上記の構成によれば、上記第2接触角が第1接触角よりも小さいことで、第2領域の方が第1領域に比べて、液滴との親液性が高いことになる。これにより、第1領域と第2領域とに跨がるように液滴を付着した場合、第1領域に付着している液滴が該第1領域よりも親液性の高い第2領域（パターン）に集まることになる。

【0140】

しかも、液滴径、配線パターン幅、第1接触角、第2接触角を上記（1）式を満たすように設定すれば、パターン幅よりも大きな径の液滴を付着させても、液滴は第2領域に集まるようになる。

【0141】

このように、パターン幅よりも大きな径の液滴を使用すれば、パターン幅と同じ径、あるいは小さな径の液滴を使用した場合に比べて、液滴の吐出数を減らすことができる。

【0142】

このように、吐出する液滴数を減らすことにより、タクトタイムの増加や液滴を吐出するための機構、例えばインクジェットヘッドの寿命低下を防止することができる。

【0143】

また、上記第1領域が液滴に対して撥液性を示す撥液領域となるように第1接触角を設定し、上記第2領域が液滴に対して親液性を示す親液領域となるように第2接触角を設定するようにしてもよい。

【0144】

この場合、第1領域が液滴に対して撥液性を示す撥液領域となり、第2領域が液滴に対して親液性を示す親液領域となるので、液滴を第1領域と第2領域とに

跨がるように付着させた場合、付着した液滴は撥液領域である第1領域では弾かれ、親液領域である第2領域では該第2領域の形状に沿って拡がる。つまり、第1領域で弾かれた液滴は、第2領域に流れ込み、第2領域に付着した液滴とともに該第2領域（パターン）に沿って拡がり配線を形成することになる。

【0145】

したがって、パターンとならない領域、すなわち第1領域を液滴に対して撥液性を有する領域にすることで、第1領域に付着した液滴を弾き、確実に第2領域に流し込むことが可能となる。

【0146】

このように、第1領域を撥液領域、第2領域を親液領域とすれば、第1接触角と第2接触角との差が大きくなり、上記（1）式の右辺が大きくなる。ここで、（1）式の右辺が大きくなることは、配線パターン幅に対する液滴径の大きさをさらに大きくすることができることを示す。

【0147】

したがって、液滴径をパターン幅に対してさらに大きくすることで、吐出する液滴数をさらに少なくでき、タクトタイムを減少させ、液滴を吐出するための機構、例えばインクジェットヘッドの寿命を延ばすことができる。

【0148】

また、本発明のパターン形成方法は、液滴を対象面上に吐出することで所定のパターンを形成するパターン形成方法において、上記液滴を吐出する前に、該液滴に対して撥液性を示す第1領域と、該第1領域に隣接し、該液滴に対して親液性を示し、形成されるべきパターンとなる第2領域とを上記対象面上に形成したときに、上記第1領域と第2領域との境界から液滴の付着中心との距離Xが、以下の（2）式を満たすように、液滴を対象面上に付着させる構成である。

【0149】

【数8】

$$X \leq \sqrt[3]{\frac{4}{2 - 3\cos\theta_1 + \cos^3\theta_1}} \cdot \frac{D}{2} \quad \dots \dots (2)$$

ここで、 X:親撥水パターン界面と液滴着弾中心との距離

D:液滴径

θ_1 :撥水部分のインクに対する接触角

【0150】

それゆえ、第1領域と第2領域との境界から液滴の付着中心との距離Xが、上記の(2)式を満たすように、液滴を対象面上に付着させることで、撥液性を示す第1領域に付着した液滴は親液性を示す第2領域に移動することができる。つまり、液滴の付着中心が第2領域になくても、液滴を第2領域に移動させることができる。

【0151】

これにより、吐出精度の低い液滴吐出機構、例えばインクジェットヘッドを使用し、液滴を基板に吐出しても、形成すべきパターンとなる第2領域に確実に液滴を集めることができるので、精度よくパターンを形成することができる。

【0152】

したがって、パターンを形成するための装置コストを低減することが可能となるという効果を奏する。

【0153】

さらに、本発明のパターン形成方法は、液滴を対象面上に吐出することで所定のパターンを形成するパターン形成方法において、上記液滴を吐出する前に、該液滴に対して撥液性を示す第1領域と、該第1領域に隣接し、該液滴に対して親液性を示し、形成すべきパターンとなる第2領域とを上記対象面上に形成したときに、液滴を付着させるときの液滴の吐出ピッチPが、以下の(3)式を満たすように、液滴を対象面上に付着させる構成である。

【0154】

【数9】

$$\frac{0.04D^3}{L} \leq P \leq \frac{0.4D^3}{L} \quad \cdots (3)$$

ここで、 P: 吐出ピッチ (μm)

D: 液滴径 (μm)

L: 親水ライン幅 (μm)

【0155】

それゆえ、吐出する液滴径とパターン幅とに対して、液滴の吐出ピッチ P を上記 (3) 式を満たすように設定することで、線幅、線厚のバラツキの少ないパターンを形成することができる。

【0156】

ここで、液滴が配線材料を含み、所定のパターンとして配線パターンを形成する場合には、配線幅、配線厚のバラツキが少なく、低抵抗かつ配線段差の少ない配線パターンを高スループットで形成することが可能となる。

【0157】

このように、液滴の吐出ピッチを上記 (3) 式を満たすように設定することで、パターンの形成に必要な液滴の吐出数を最小限にすることが可能となり、タクトタイムの減少や液滴を吐出する機構（インクジェットヘッド）の延命化を図ることができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明のパターン形成基材を示し、(a) は側面図、(b) は平面図である。

【図2】

(a) は液滴の撥水性を説明する図であり、(b) は液滴の親水性を説明する図である。

【図3】

(a) ~ (d) は、基板上に親水領域と撥水領域とを形成するための工程を示す図である。

【図4】

液滴径とピッチとの関係とを示すグラフである。

【図5】

本発明のパターン形成方法に適用されるパターン形成装置の概略斜視図である

【図6】

(a)～(c)は、本発明の他のパターン形成方法を示す図である。

【図7】

(a) (b)は、本発明のさらに他のパターン形成方法を示す図である。

【図8】

(a) (b)は、本発明のさらに他のパターン形成方法を示す図である。

【符号の説明】

- 1 ガラス基板
- 2 濡れ性変化層
- 3 フオトマスク
- 4 マスクパターン
- 5 光触媒層
- 6 親水ライン（第2領域）
- 6 a 親撥水境界
- 7 撥水領域（第1領域）
- 8 液滴
- 1 1 基板（パターン形成基材）
- 1 2 ステージ
- 1 3 インクジェットヘッド
- 1 4 y方向駆動部
- 1 5 x方向駆動部
- 1 6 液滴供給システム
- 1 7 装置コントロールユニット
- 1 8 液配管
- 2 1 親水ライン（第2領域）

21a～21d 親水ライン

22 撥水領域（第1領域）

23 液滴

D 液滴径

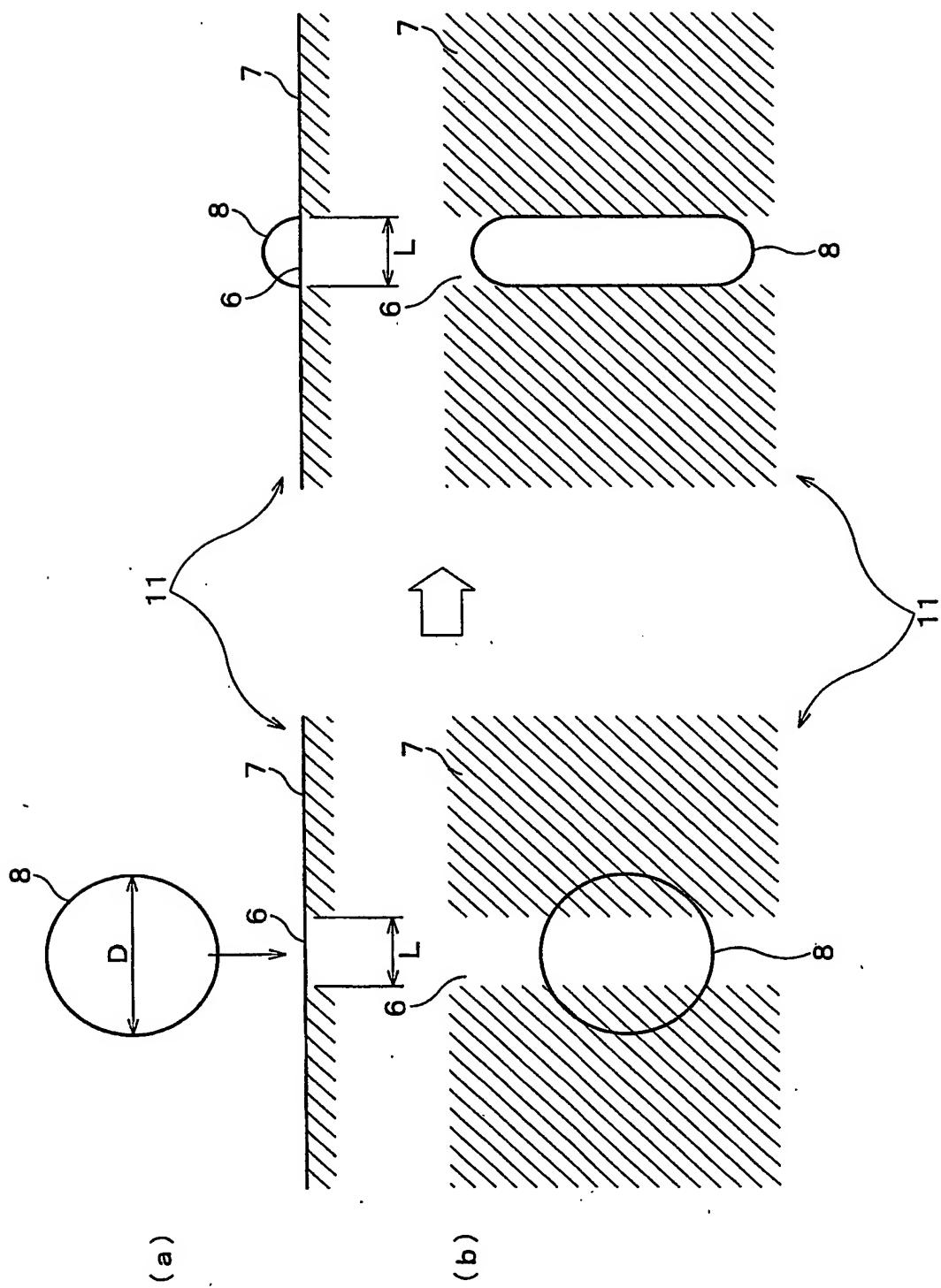
L 親水ライン幅（パターン幅）

θ_1 第1接触角

θ_2 第2接触角

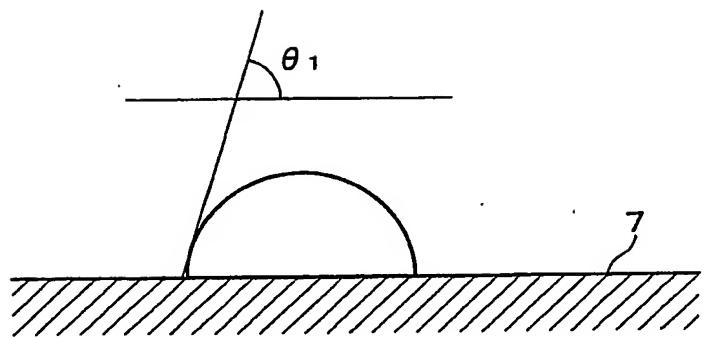
【書類名】 図面

【図1】

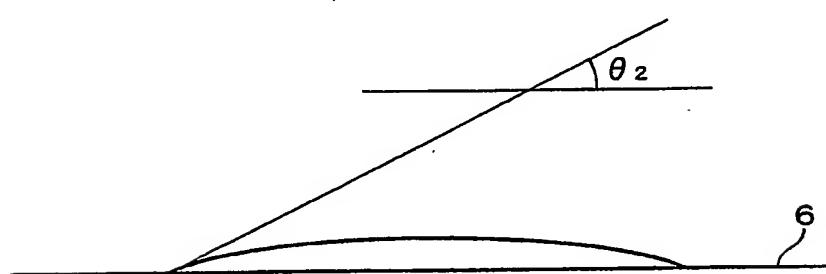


【図2】

(a)

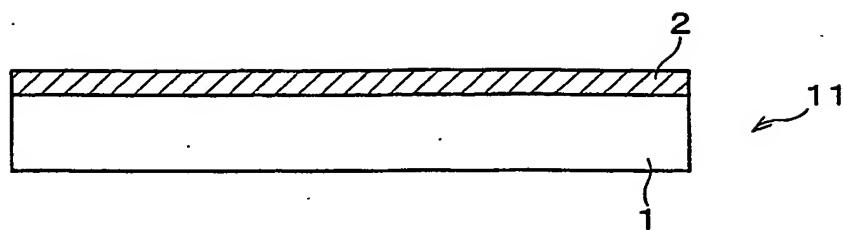


(b)

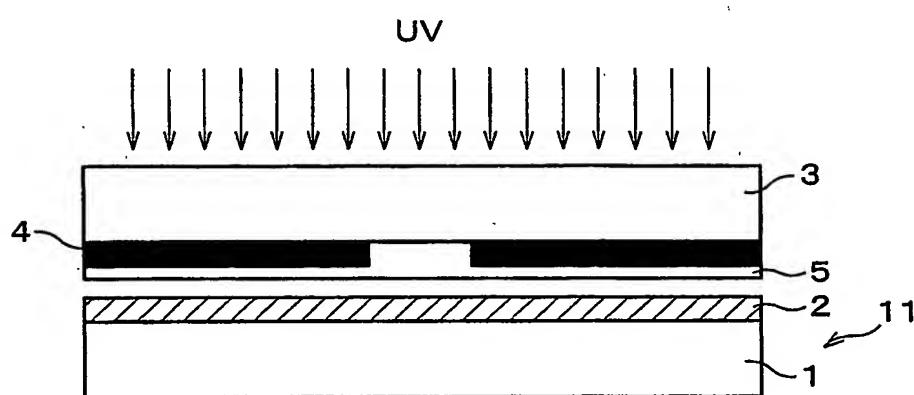


【図3】

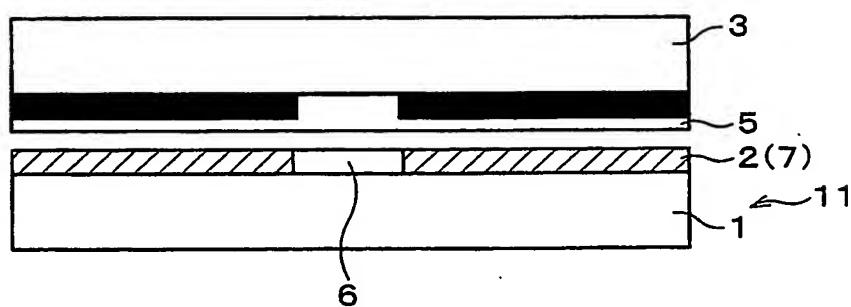
(a)



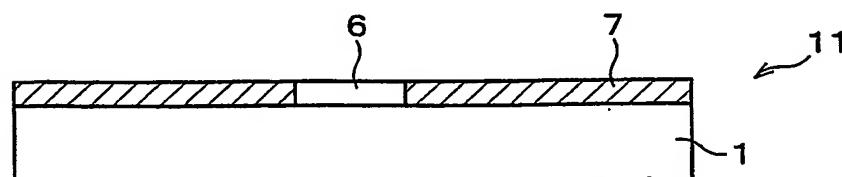
(b)



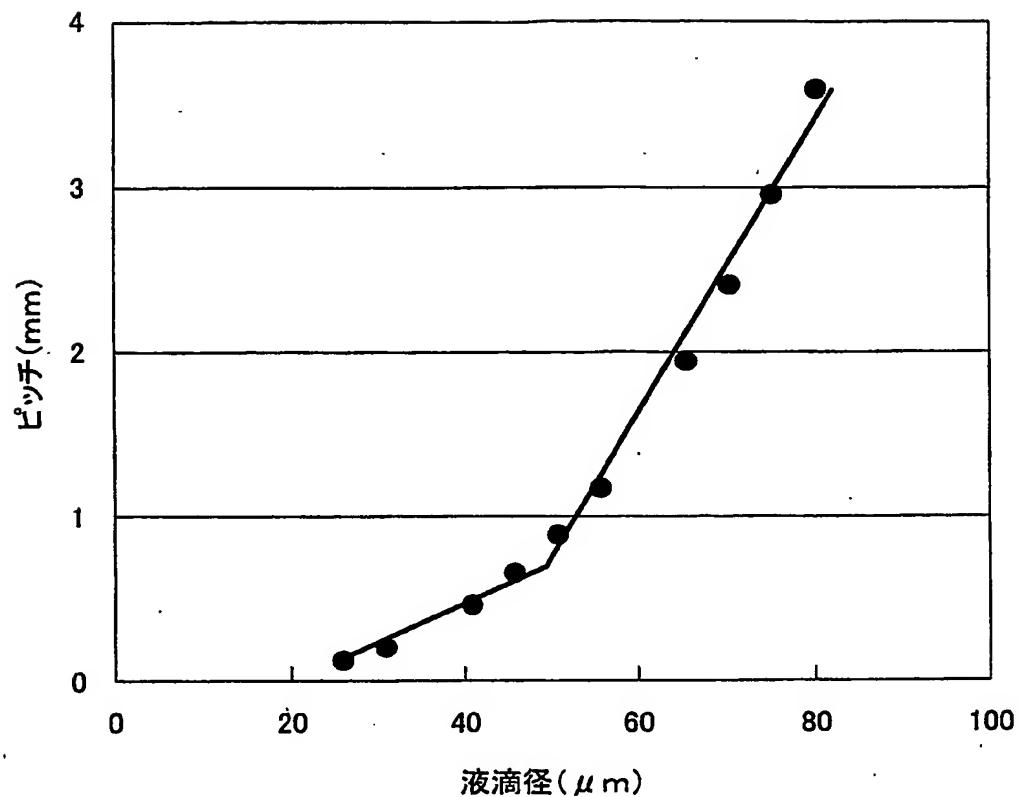
(c)



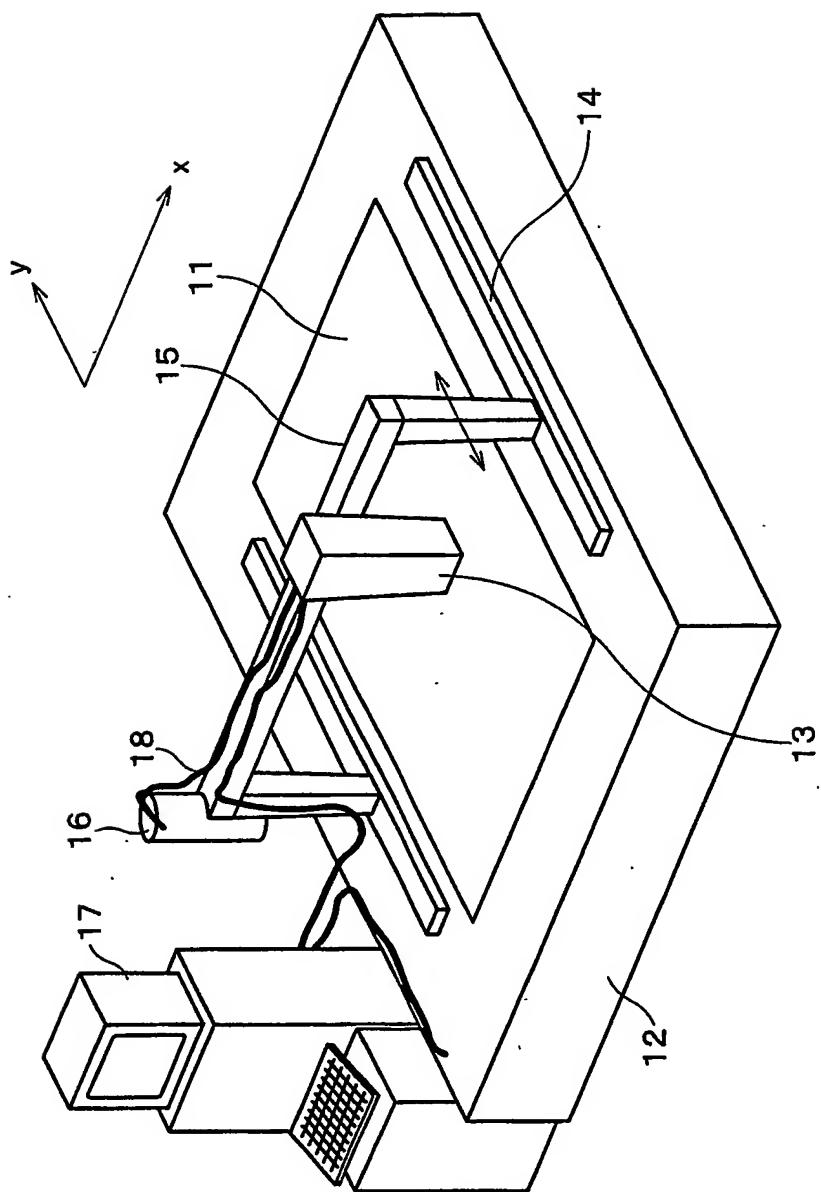
(d)



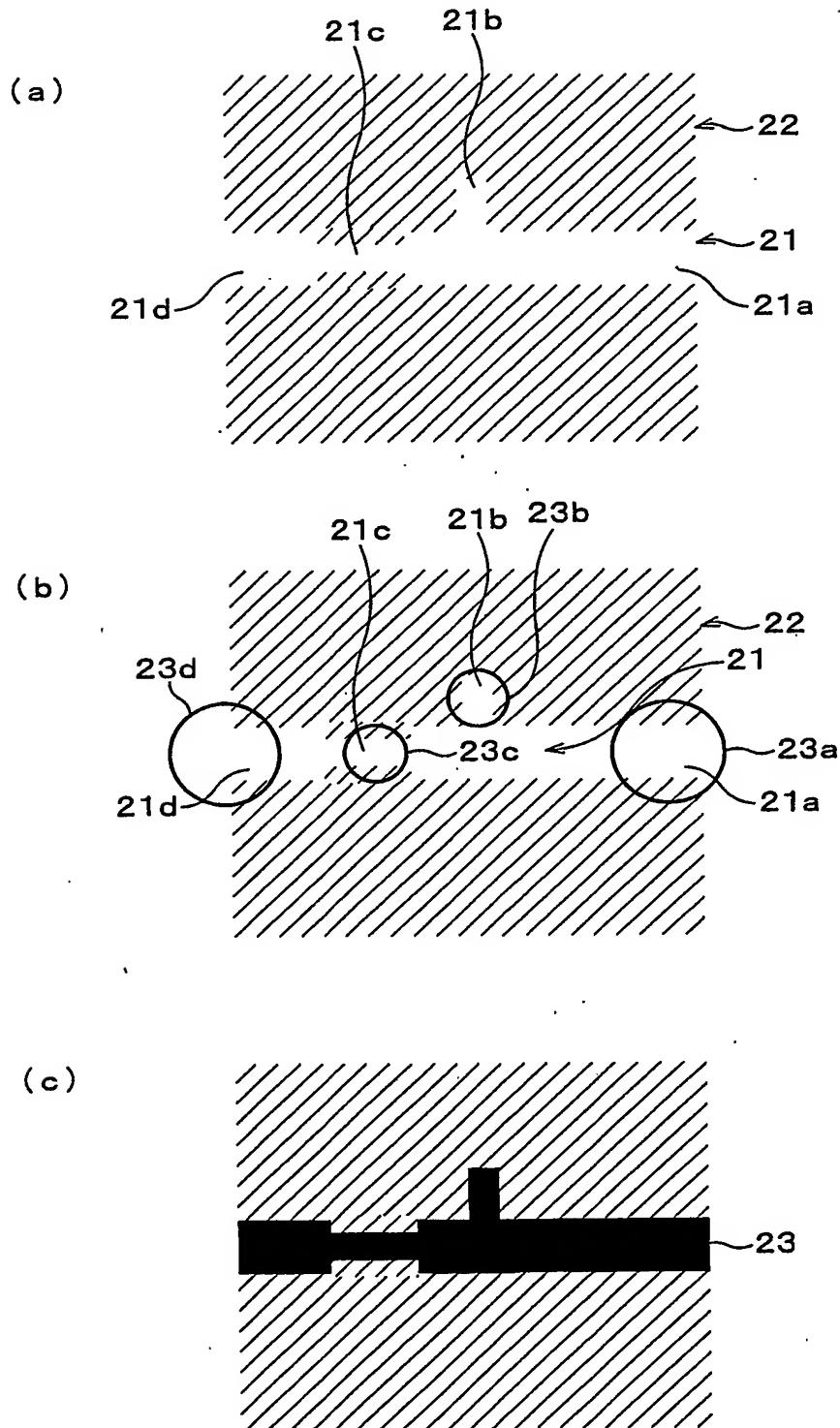
【図4】



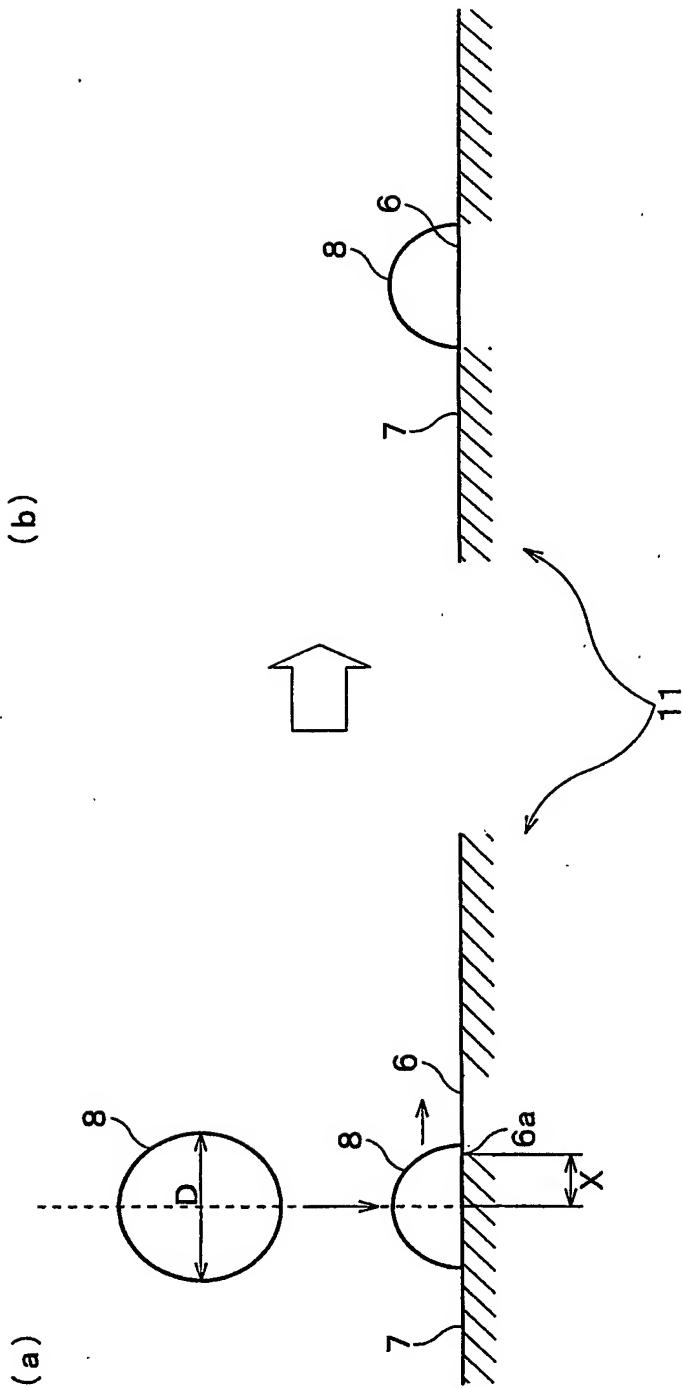
【図5】



【図6】

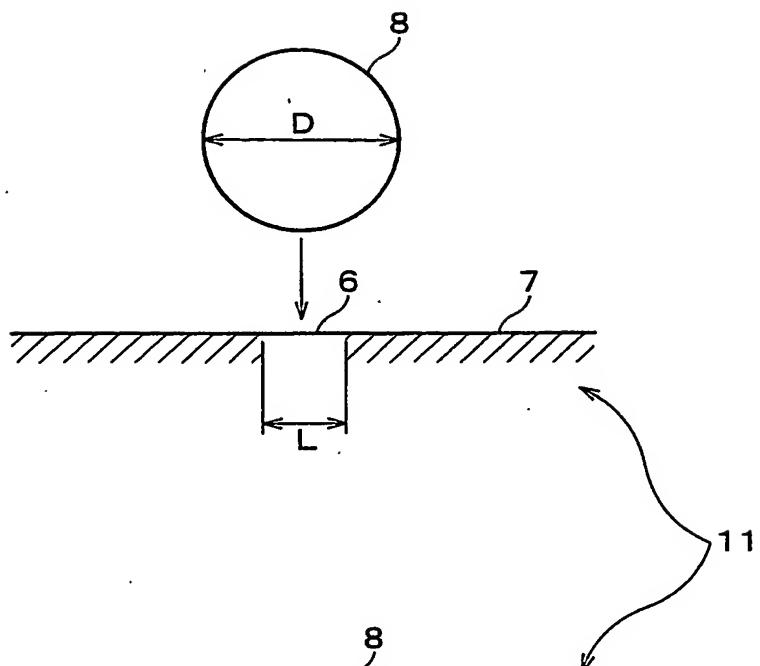


【図7】

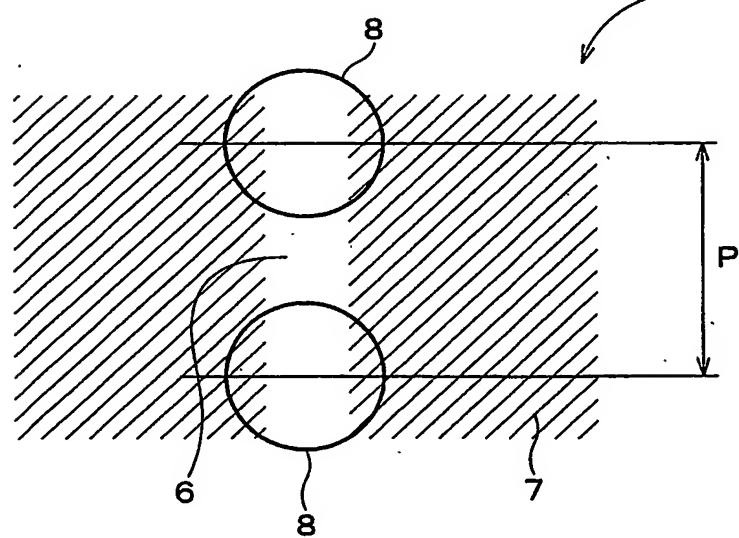


【図8】

(a)



(b)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 吐出する液滴数を減らすことにより、タクトタイムの増加やインクジェットの寿命低下を防止できるパターン形成方法を提供する。

【解決手段】 液滴8を基板11上に吐出する前に、該液滴8が対象面上に接触したときの接触角が第1接触角である撥水領域7と、この撥水領域7と隣接し、上記第1接触角よりも小さな第2接触角であり、形成されるべきパターンとなる親水ライン6とを、上記基板11上に形成するとき、以下の(1)式を満たすように、上記撥水領域7と親水ライン6とに跨がるように液滴を付着させる。

$$D \leq L \times \{1 + 2 (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)\} \quad \dots \dots \quad (1)$$

ここで、D：液滴径、L：パターン幅、 θ_1 ：第1接触角、 θ_2 ：第2接触角である。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000005049]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

氏 名 シャープ株式会社